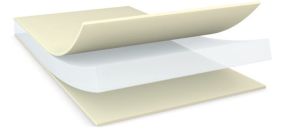




tesa® 60744

产品信息



50 µm 热管理胶带

产品描述

tesa® 60744 是一款无基材的导热胶带，专用于电子设备的热源元器件或热传导材料中，要求高导热率的粘接，如：显示屏粘接，MLB粘接和元器件粘接等。

产品特性：

- 高导热性
- 高粘
- 优秀的表面浸润性
- 易于处理
- 薄结构设计
- 高绝缘性

特点

- High thermal conductivity in z-direction
- Strong bonding strength
- Excellent surface wet-out
- Easy handling
- Thin design
- Excellent electrical insulation

应用

- 元器件粘接（需要热传导）
- 从MLB/FPC到散热器的散热应用
- 显示屏粘接和热传导到其他介质
- 蒸发器或热管粘接
- 天线粘接
- 石墨片粘接



tesa® 60744

产品信息

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无	• 总厚度	50 µm
• 胶粘剂类型	丙烯酸	• 颜色	白色
• 离型纸类型	PET (聚酯) 薄膜	• 离型纸颜色	透明

属性/性能值

• 击穿电压	2.9 KV	• 浸润性	84 %
• 导热率 z方向	1 W/mK		

粘接力值

• 钢表面粘接强度 (初始)	5 N/cm
------------------	--------

附加信息

Thermal conductivity measured by ASTM D5470

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=60744>